

한일 뿌리기업 비즈니스 매칭 상담회

참가 기업 추가 모집

서울시 우수 뿌리기업 및 기계금속 소공인의 해외 판로 개척을 위해
일본 오사카 현지 기업과의 비즈니스 매칭을 지원합니다!

Benefits 1

비즈니스 매칭

일본 오사카 현지 기업과의
1:1 매칭 상담회 기회

Benefits 2

부스공간 및 통역

상담회에 필요한 부스 및
통역 지원

Benefits 3

오사카 현지 숙박

최대 2박(1인)의
현지 숙박 지원
*항공, 체제비 등 자부담

모집대상 서울시 뿌리기업, 기계금속 소공인 / 2개사 추가 모집

행사일정 2026년 9월 29일 (상담회), 9월 30일(일본 시장 세미나)

개최장소 오사카 산업창조관(예정)

신청기간 공고일로부터 ~ 2026. 8.14.(금) 18:00

신청방법 QR코드 스캔 후 신청서 작성

